

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

(记录表编号：2025-0101)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 一对一沟通	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年11月1日-12月31日		
地点/方式	券商策略会、现场调研		
参与单位 (或人员)	财通证券、长江证券、东北证券、东方证券、国海证券、国联证券、国盛证券、国信证券、海通证券、华安证券、华创证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、美银证券、天风证券、万联证券、西部证券、招商证券、浙商证券、中信证券、信达证券、海通证券、美银证券、国投证券、国泰君安证券、华金证券、南方基金、中金公司、圆信永丰基金、博时基金、富兰克林华美投信、易方达基金、大成基金、华安基金、华泰资产、宏利基金、交银施罗德基金、兴业基金、诺安基金、海富通基金、嘉实基金、建信基金、前海开源基金、富兰克林华美、文渊资本、工银瑞信基金、泓德基金、恒越基金、鹏华基金、施罗德基金、国投瑞银基金、国联基金、善择基金、上银基金、万家基金、Point72、Causeway Capital、Library Group、前海人寿保险、前海再保险、太平洋资产、光大保德信基金、人保资产、中银理财、中金资管、鲸鸿基金、广文投资、工银瑞信基金、永赢基金、泰康资产、泰康基金、中信资管、仁桥资产、财通基金、银华基金		
上市公司 接待人员	董事会秘书：黄恬先生 证券事务代表：蒋靖怡女士		
活动 主要内容	问：公司四季度的稼动率情况如何？ 答：2024年以来，公司产能利用率持续保持在较高水平，目前看四季度		

稼动率比三季度略升，公司订单储备充足，秉承“以销定产、柔性生产”的策略，全力满足客户的需求。

问：公司近期原材料价格变化情况？

答：公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、金盐、干膜、油墨等，覆铜板、铜、金盐等原材料的价格在 2024 年二季度增长较快，目前处于企稳阶段。公司通过扩大供应渠道、优化供应链管理、加强库存管理、研发技术创新等方式，最大程度降低原材料价格波动风险。

问：请介绍公司 HLC 和 HDI 产品技术能力情况？

答：HLC 工厂量产产品最高层数突破 40 层、平均层数 12 层以上，HDI 工厂具备任意层互联及 mSAP 生产能力，主要应用于高端消费电子、通信、算力、汽车电子等下游领域。2024 年以来高技术、高附加值的珠海金湾 HLC、HDI 工厂各项业务持续推进，产量产值稳步提升，助力公司产品结构优化升级和盈利能力改善。

问：公司在 2024 年如何优化产品结构？这种优化对利润有何贡献？

答：公司产品下游应用领域广泛，近年来，电动化、智能化、网联化重构汽车产业链，公司品质要求更严格、可靠性要求更强的汽车电子业务规模不断增长；AI 高速发展，从云侧向端侧不断延展，公司也抓住机遇，积极布局高端产品。产品结构优化助益公司在 2024 年前三季度实现业绩同比提升。

问：公司未来是否有机会切入卫星通信赛道？

答：从技术储备上看，公司《低轨道卫星用 PCB 空腔板制作关键技术研发》被评为国内领先技术，两项专利“US17/826501 不对称板”及“US17/768665 一种非对称板的制作方法”已成功获得美国专利授权，新结构和制作方法能够提高产品的可靠性和信号精度，目前已在毫米波雷达、低轨卫星通信、AI 算力等高端领域得到应用。从产品布局看，公司生产的高速多层板、高频微波板、多功能金属基板、空气腔板产品可用于通信基站、卫星通信、低轨卫星互联网通信领域，其中多款产品已量产。公司将积极关注市场需求变化，配合下游客户展开相关产品的研发布局。

	<p>问：随着 AI 终端硬件的百花齐放，FPC 软板的 ASP 是否有提升？是否为公司 FPC 业务带来正面影响？</p> <p>答：FPC 和硬板相比在空间节省以及互联方面有较多优势，因此被广泛应用于轻量化、小型化的电子产品中。随着 AI Phone、AIPC 及其他智能硬件的渗透率不断提升，FPC 的用量逐步增加，整体呈现量价齐升的趋势。公司在消费电子领域拥有较多优质的客户资源，积累了雄厚的技术实力，今年以来高端 FPC 的需求持续增长也促使公司加快排产进度。</p> <p>问：公司未来的业务方向？</p> <p>答：公司 PCB 产品品类较全，能为下游客户提供综合解决方案，凭借在汽车智能化、智能终端硬件、通讯设备等领域的丰富的技术储备及客户优势，持续为各合作伙伴提供优质产品和服务，持续提升生产制造能力，努力满足客户需求。</p> <p>问：公司近几年的扩产的资金来源？</p> <p>答：此前公司曾通过发行可转债募集资金的方式建设高端产能项目，目前公司资产负债率较低。公司将根据公司战略布局规划、外部经营环境、相关政策变化及实际需求来制定公司中长期投融资计划。</p> <p>注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件	无
记录时间	2025 年 1 月 2 日整理